

「持続可能性と革新」FICTが描くPCB技術の未来



「持続可能な社会を創造するために、ビジネスパートナーやテクノロジーパートナーと共に前進」

FICT株式会社 代表取締役社長 三好 清司
(2023年8月取材)

1967年に富士通のPCB事業部門として設立されたFICTは、現在、独立した企業として、グローバルな顧客に先進的なPCBソリューションを提供し続けてきた。

2001年には、有機フリップチップBGA基板 (FC-BGA) を発明し、この技術は現在、半導体パッケージ基板の世界標準として認知されている。CEOの三好清司

FICTは、検査用プローブカードの世界市場において、真のキープレーヤーとなるべく尽力を続けている。

氏は、「この技術をプローブカード製品に適用することで、高性能のSTボードを開発し、当社はテスト用プローブカード市場での地位を確立した」と語る。

同社が開発したもうひとつの画期的技術が、ペースト充填とメタルボンディングにより、プリント配線板 (60層以上) の配線容量を最大化するF-ALCS (F-All Layer Connection Structure)

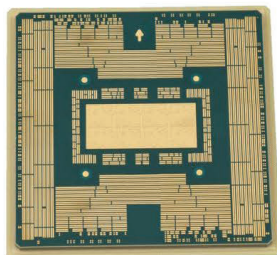
だ。「この技術の特徴は、現代の高まる環境問題との整合性にあります。サステナビリティが重視される昨今、私たちは廃水処理と電力消費を可能な限り削減するための代替プロセスソリ

ューションを探しています」と三好氏は続ける。「高速通信の領域が限界を押し広げる中、信号伝送は今や100 GHzを超えて急上昇していますが、従来のスルーホールスタブではこの波長内で破壊的な干渉が発生します。対照的に、当社

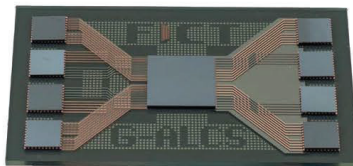
の導電性ペーストを使用することにより、ワンタイムラミネーションアプローチの任意の層IVH (インタースティ

ャルピアホール) は、スタブレスのないソリューションとなり、中絶のない高速伝送が可能になります」

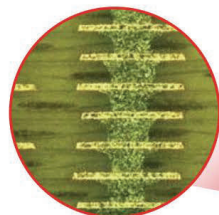
配線ピッチの微細化が進む中、ガラス基板への移行の



プローブカード (STボード)



多層ガラス基板試作品 (G-ALCS技術)



F-ALCS技術による76層プリント基板断面図

重要性が増している。FICTは、G-ALCSとして知られるF-ALCS技術の進化を通じて、合わせガラス技術の開発に注力している。

三好氏は最後に、「今後もビジネスパートナーやテクノロジーパートナー、そして顧客との連携を深め、高度な技術を駆使して持続可能な社会の実現を目指す」と締めくくった。